

中颖电子股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为了支持全资子公司合肥中颖电子有限公司（以下简称“合肥中颖”）的业务发展，提升公司整体效益，公司同意拟以上限人民币500万元为资产负债率低于70%的合肥中颖提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为0.29%。

按照《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 名称：合肥中颖电子有限公司
- 统一社会信用代码：91340100MA2UD9WH6B
- 成立日期：2019年12月11日
- 注册地址：合肥市高新区创新大道2800号集成电路专业孵化器F1-1301/1309 室
- 法定代表人：杨晓勇
- 注册资本：人民币9,720万元
- 经营范围：集成电路的设计、制造、加工、销售、售后服务及技术服务；电子系统模块的研发、销售、售后服务及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 与本公司关系：系公司于2019年12月11日设立的全资子公司。

9、合肥中颖主要财务指标

单位：人民币 万元

项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	16,721.81	20,202.28
营业利润	-267.98	1,137.41
净利润	-106.17	1,266.30
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	76,602.19	77,047.05
负债总额	14,170.47	19,459.16
净资产	62,431.72	57,587.89

注：上述2024年度数据已经审计，2025年前三季度数据未经审计

10、经查询，被担保人不属于失信被执行人

三、拟签署保证函的主要内容

1、委托供应商华虹半导体制造（无锡）有限公司（以下简称“华虹半导体”）进行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限人民币500万元为合肥中颖提供连带责任保证担保；

担保期限：10年；

公司与华虹半导体没有关联关系。

本次担保事项经董事会审议通过后，公司将与供应商签订相关保证函。

四、董事会意见

合肥中颖是公司全资子公司，其生产经营情况正常，本次担保有利于合肥中颖经营更有效地开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关政策法规，合肥中颖最近一期资产负债率为18.50%，公司能有效地控制和防范风险，董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

截至本公告日，公司已审议批准的担保额度为人民币38,300万元，实际对外担保（包括母公司为全资子公司、控股子公司及控股孙公司）总金额为人民币

35,800万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为20.55%，占公司总资产的比例为15.69%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2025年11月18日